

1-215079-8 ✓ AKTIV

Micro-MaTch | Micro-MaTch Industrial

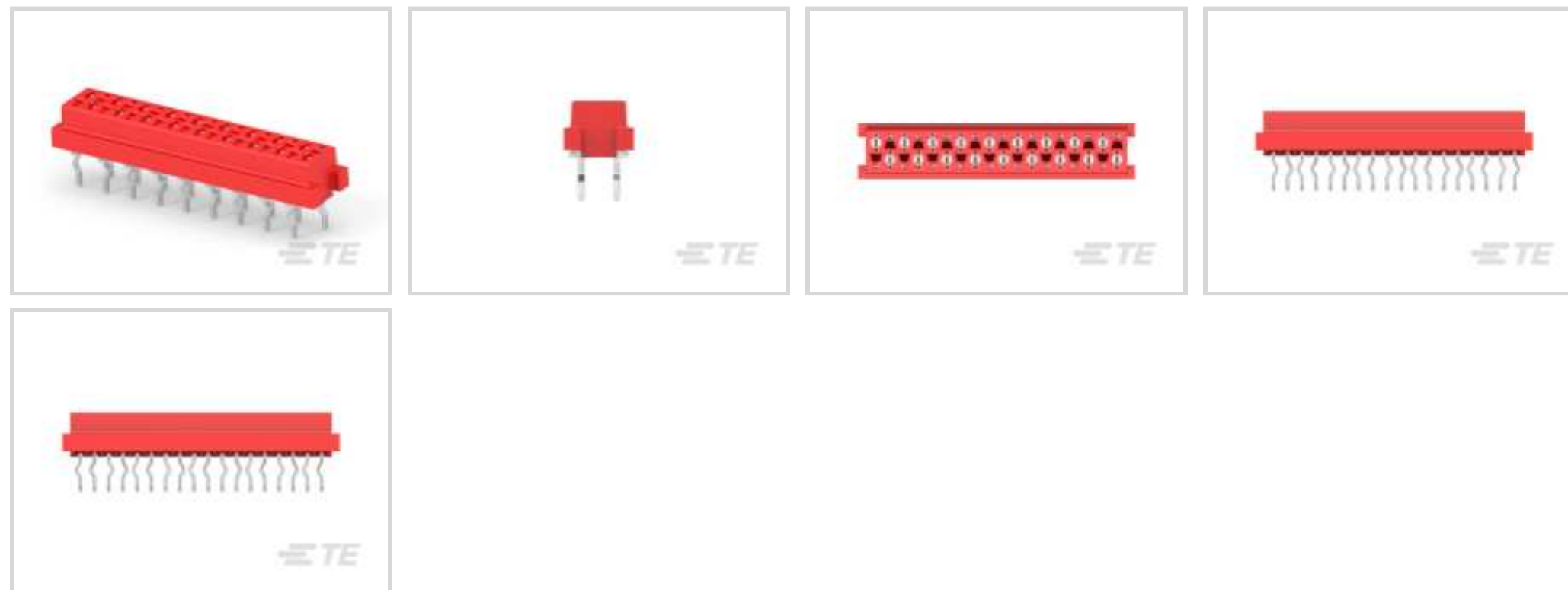
Interne TE-Nummer 1-215079-8

Ribbon Cable Connectors, Board-to-Board, 18 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Vertical, Through Hole - Solder, 2 Row, Micro-MaTch Industrial

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Flexible Flachkabel-, FPC- und Bandsteckverbinder > Flachbandkabel-Stecker > Buchse-auf-Leiterplatte-Anschluss, von oben steckbar



Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **18**

Raster: **1.27 mm [ .05 in ]**

Arretierung für Leiterplattenmontage: **Mit**

Art der Leiterplattenmontage: **Geknickte Lötendstücke**

[Alle Buchse-auf-Leiterplatte-Anschluss, von oben steckbar \(67\)](#)

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Flachbandkabel-Steckverbindertyp	On-Board-Buchse
Flachbandkabel-Steckerbinder-Stecksocketyp	Gehüllt
Produkttyp des Steckverbinders	Steckverbindersatz
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Steckverbinder- und Gehäusetyyp	Buchse
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	18
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Zeilenanzahl	2

### Elektrische Kennwerte

Isolierwiderstand	1000 MΩ
-------------------	---------

Arbeitsspannung	100 VAC
-----------------	---------

### Sonstige Eigenschaften

Verkettung	Ohne
------------	------

Primäre Produktfarbe	Rot
----------------------	-----

Profil des Steckverbinders	Standard
----------------------------	----------

### Kontaktmerkmale

Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	3 – 5 µm[118.11 – 196.85 µin]
---	-------------------------------

Kontakttyp	Stecksockel
------------	-------------

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	3 – 5 µm[118.11 – 196.85 µin]
---	-------------------------------

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
--	------

Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
--	------

Kontaktform	Doppelstrahl, Doppelstrahl
-------------	----------------------------

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
---	--------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
---	------

Kontaktmaterial	Phosphorbronze
-----------------	----------------

Kontakt-nennstrom (max.)	1 A
--------------------------	-----

### Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke	.25 mm[.01 in]
---	----------------

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite	.5 mm[.02 in]
--	---------------

Anschlussstift- und Restlänge	3.1 mm[.122 in]
-------------------------------	-----------------

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten
-------------------------------------	---------------------------

### Montage und Anschluss-technik

Gegensteckführung	Mit
-------------------	-----

Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse	Press-Fit
--------------------------------------	-----------

Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
-------------------------------------	------

Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
--------------------------------------	-----

Art der Leiterplattenmontage	Geknickte Lötendstücke
------------------------------	------------------------

Gegensteckarretierung	Mit
-----------------------	-----

Typ der Gegensteckarretierung	Kontaktreibung
-------------------------------	----------------

Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage
--------------------------------	----------------------

### Gehäusemerkmale

Steckeingangsposition	Oben
Gehäusematerial	PBT GF
Raster	1.27 mm [.05 in]

### Abmessungen

Steckverbinderlänge	24.9 mm [.98 in]
Steckverbinderhöhe	4 mm [.16 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.6 mm [.062 in]
Reihenabstand	2 mm [.059 in]

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Lötverfahrenfunktion	Plattenabstand
Stromkreis Anwendung	Signal

### Industriestandards

UL-Grad	Zulassung
Behörde/Norm	UL
Zugelassene Standards	UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	2500
Verpackungsmethode	Trommel

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br

oder Cl &gt; 900 ppm.

Lötbarkeit

Wellenlötbar bis 265 °C

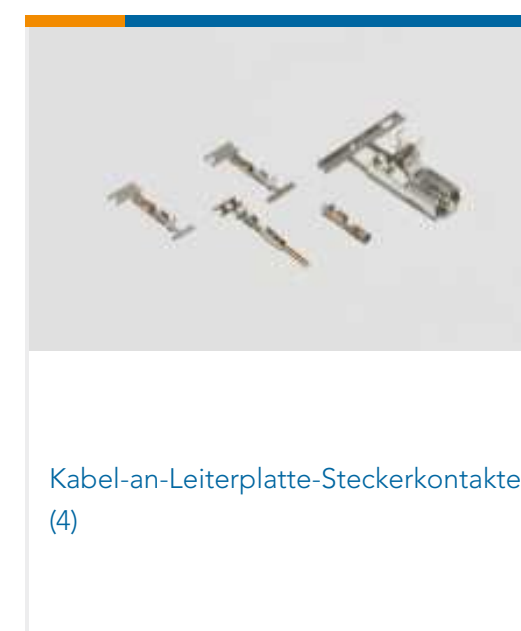
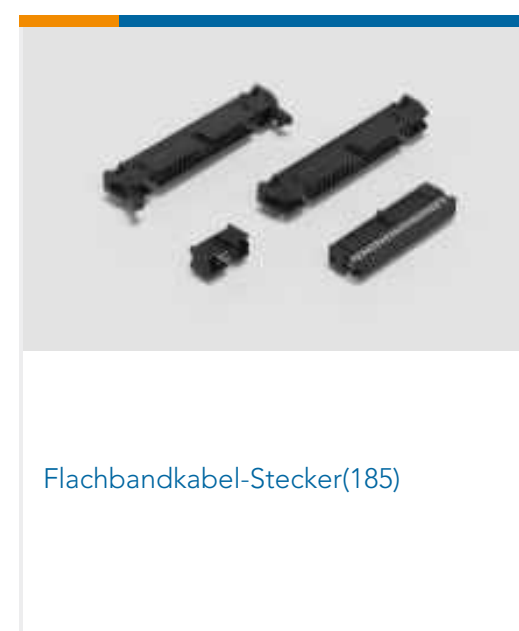
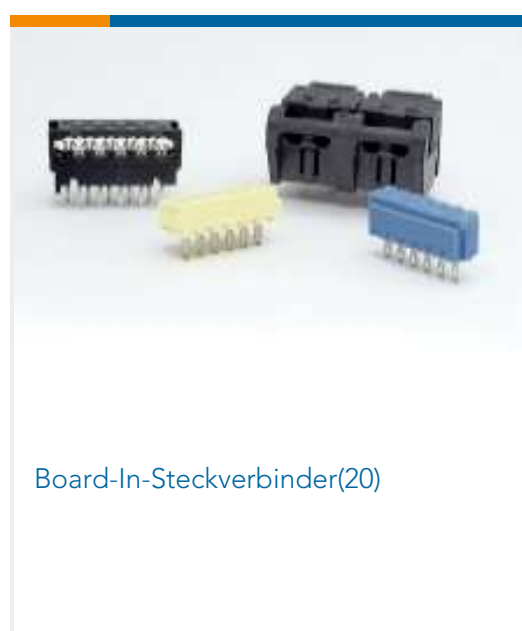
## Produktkonformitäts-Disclaimer

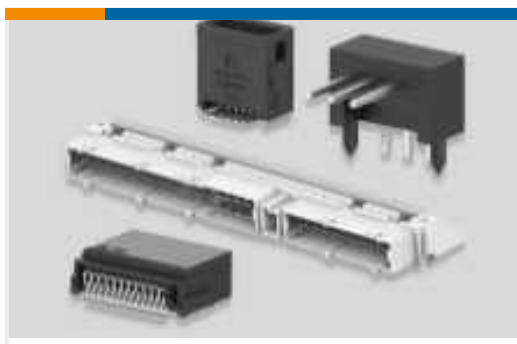
Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



## Auch serienmäßig | Micro-MaTch Industrial



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen  
(1)

Steckbare I/O-Kabelsätze(52)

## Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:1558666-3  
T9GS1L14-12TE Teilnr.:215460-6  
MICRO-MATCH FEM.SETE Teilnr.:1-338070-0  
MICRO-MATCH FEM.SETE Teilnr.:1-215079-6  
Buchse-auf-Leiterplatte-Anschluss, von oben steckbar

## Dokumente

### Produktzeichnungen

#### MICRO-MATCH FOB 18P

Englisch

### CAD-Dateien

#### 3D PDF

3D

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-215079-8\\_T.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-215079-8\\_T.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-215079-8\\_T.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Datenblätter/ Katalogseiten

#### Micro-MaTch Catalog

Englisch

#### Ribbon Cable Interconnect Solutions

Englisch

#### Centerline Micro-Match Connector Series

Englisch



## Produktspezifikationen

### Produktspezifikation

Englisch

---

## Umweltverträglichkeit von Produkten

### Product Compliance

Englisch

### Product Compliance

Englisch

---

## Freigabe Agentur

### UL-Bericht

Englisch